

## 6英寸耐酸碱Ptfе圆形晶圆载具 半导体清洗篮 可定制

货号: PL-CP207



### 简介

专为半导体清洗设计的高纯度6英寸PTFE圆形晶圆载具。对食人鱼溶液和氢氟酸蚀刻具有优异的耐酸碱性能。精密加工、完全可定制的清洗篮，确保在苛刻的湿法化学处理、浸泡浴和超声波漂洗过程中安全地处理基板。

### [了解更多](#)

应用	描述	主要优势
RCA清洗工艺	使用SC-1和SC-2溶液去除硅晶圆上的有机残留物、薄氧化层和离子污染。	高耐热和耐化学性防止载具在热浴浸泡过程中降解。
食人鱼蚀刻	在硫酸和过氧化氢的混合物中处理晶圆以去除重有机物。	对强氧化环境的卓越耐受性确保设备使用寿命长。
氢氟酸 (HF) 浸泡	在不同浓度的HF中去除硅表面的牺牲氧化层或原生氧化物。	材料纯度可防止金属离子进入敏感的蚀刻环境。
CMP后漂洗	在化学机械抛光后，通过清洗循环运输晶圆以去除浆料颗粒。	光滑、不粘的表面可防止颗粒滞留，并有助于有效的超声波清洗。
太阳能电池制造	在制绒和磷扩散步骤中处理6英寸单晶或多晶硅晶圆。	坚固的结构支持苛刻工业生产线的高通量生产。
光刻	在使用溶剂和专用剥离剂进行光刻胶显影和剥离时支撑基板。	通用溶剂兼容性防止载具框架膨胀或软化。
超声波清洗	在超声波或兆声波浴中携带精细组件以进行高精度污染物去除。	结构刚性允许声能有效传递到晶圆表面。
化合物半导体蚀刻	在用于光电器件制造的特殊化学混合物中处理GaAs、InP或SiC晶圆。	可定制的槽几何形状适应不同的晶圆厚度和脆弱的基板材料。

参数	PL-CP207 规格详情
型号标识	PL-CP207
材料结构	高纯度原生PTFE ( 可选定制PFA )
晶圆尺寸兼容性	6英寸 / 150毫米直径
几何结构配置	圆形清洗篮 / 花篮式
化学兼容性	通用耐受性 ( 酸、碱、溶剂、氧化剂 )
温度耐受性	适用于低温至高温处理
定制能力	完全可定制尺寸、槽数量和手柄配置
表面处理	精密加工、超光滑、无孔
批次容量	根据客户特定晶圆数量要求定制设计
制造方法	定制CNC加工 / 定制制造